

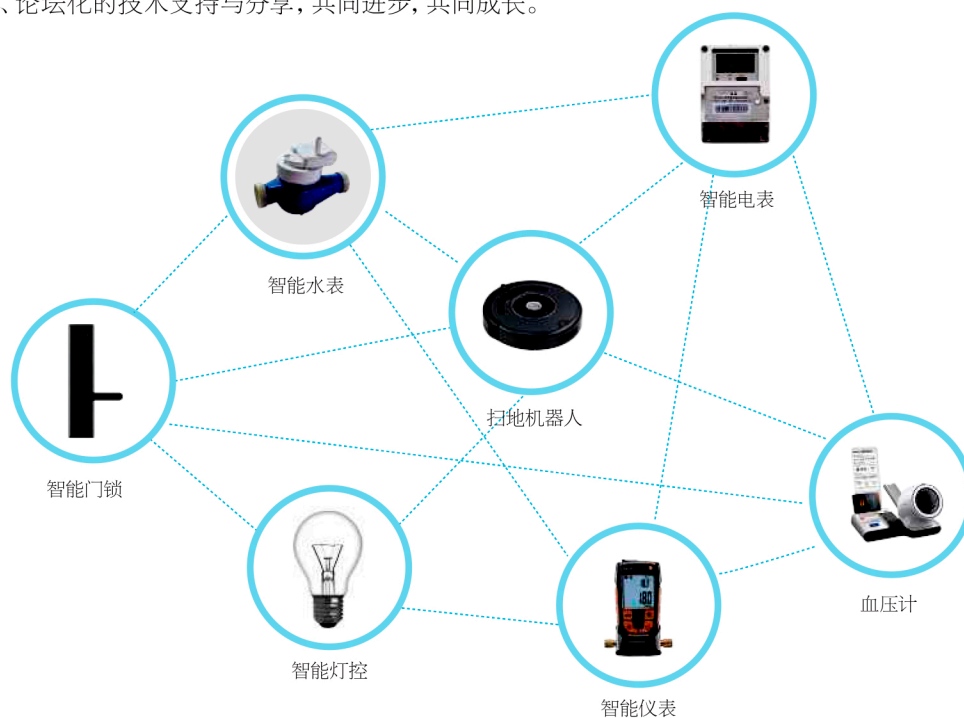
低功耗蓝牙模组解决方案

具有射频设计相关丰富经验的研发团队，专业的射频产品生产产线，降低射频产品的开发难度，帮助客户省去射频研发调试周期，助力客户快速推出产品抢占市场先机。

多种国内外芯片平台方案，多款尺寸的模组封装，搭配不同形式的天线，满足客户不同场合、不同产品上的蓝牙模组需求。

利尔达对蓝牙部分的SDK单独封装，提供OpenCPU的形式进行二次开发，简单方便地当普通MCU开发，相当于节省一颗MCU的成本。

提供本地化、论坛化的技术支持与分享，共同进步，共同成长。



SDK二次开发		
BLE 0xFE60	AD	ROM
GPIO	CPU	RAM
Timer	UART	SPI/I ² C

案例介绍



某客户蓝牙智能仪表套装，通过低功耗蓝牙模组与手机完成数据交互，将手机APP界面直接作为仪表的另一个显示界面。